

# 宽禁带功率半导体烧结银 烧结银膏

产品名称	宽禁带功率半导体烧结银 烧结银膏
公司名称	善仁（浙江）新材料科技有限公司
价格	29000.00/件
规格参数	品牌:善仁新材 颜色:银色 粘度:8000
公司地址	嘉善县姚庄镇宝群东路159号 - 2二层
联系电话	021-54830747 13611616628

## 产品详情

### 宽禁带功率半导体烧结银 烧结银膏

如何降低芯片封装纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前纳米银研究的重要内容。芯片封装纳米烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要了。善仁新材研究院根据客户的使用情况，总结出芯片封装纳米烧结银的工艺流程供大家参考：善仁新材的芯片封装纳米烧结银包括AS9330系列和AS9375两个系列，其中AS9330为半烧结银膏，AS9375为全烧结银膏。芯片烧结银的工艺流程如下：1 清洁芯片和被粘结的界面2 假设界面表面能太低，建议提高界面表面能3 粘结尺寸过大时，建议一个界面开导气槽4 一个界面涂布烧结银时，涂布的要均匀5 芯片放到涂有烧结银的界面上时，建议加一点压力到上界面压一下6 烧结时需逐步阶梯升温到一定的温度，比如3分钟升高5度等7 烧结结束时，建议在烘箱中逐步降温到室温再把器件拿出8 烧结银烧结时，要注意烧结温度，烧结时间，烧结压力”铁三角“的调整问题。